

● TSOT-26 パッケージ許容損失

TSOT-26 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基板：銅箔 4 層基板 76.2mm×114.3mm (片面約 8700mm<sup>2</sup>)

に対して銅箔面積

1 層目：25mm×50mm\_2 ピンと接続有

25mm×50mm\_3 ピンと接続有

2 層目：35mm×70mm\_2 ピンと接続有

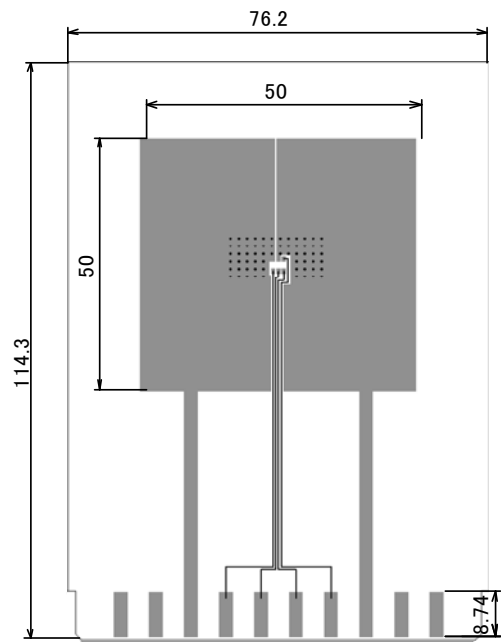
35mm×70mm\_3 ピンと接続有

3 層目：35mm×70mm\_2 ピンと接続有

35mm×70mm\_3 ピンと接続有

4 層目：25mm×50mm\_2 ピンと接続有

25mm×50mm\_3 ピンと接続有



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装 (T<sub>jmax</sub>=125°C)

周囲温度 (°C)	許容損失 Pd (mW)	抵抗値 (°C/W)
25	1300	76.92
105	260	

